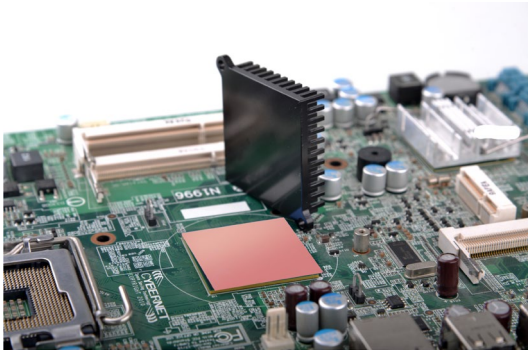


高导热硅胶垫片

TP800-H60-9是一款高导热性能的材料，表面一致性非常好，可用于填充小缝隙和不均匀表面，与各种形状和尺寸部件进行均匀接触，低压缩力下表现出较低的热阻和较好的电气绝缘特性。



特性和优点

- 导热系数: 8.0W/(m·K)
- 高导热
- 低渗油
- 高电气绝缘
- 低压缩应力
- 低热阻

典型应用

- 电压调节模块 (VRMs)
- ASICs和DSPs
- 高导热需求模块
- 高热量BGAs
- CD ROM/DVD ROM
- 网络通信设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	红色	目视
厚度(mm)	0.5~5.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.35	ASTM D792
硬度(Shore 00)	60	ASTM D2240
重量损失(%,挥发、渗出)	≤0.7	滤纸吸附@压缩25%/125°C/48h
耐温范围(°C)	-40~150	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	>6.0	ASTM D149
介电常数(@1MHz)	7.2	ASTM D150
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	8.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W @20psi,1.0mm)	0.08	ASTM D5470